

# Multi Line AOI für THT

## AOI system for THT assemblies

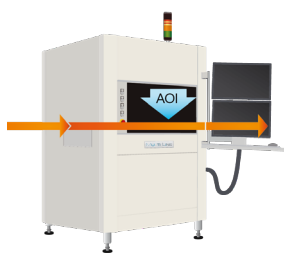
- Inspektion von THT-Bauteilen, THT-Lötstellen und SMD-Bauelementen
- beidseitige Inspektion von THT-Baugruppen im oberen oder unteren Transportmodul, mit oder ohne Werkstückträger
- vollautomatische AOI-Programmerstellung mit MagicClick in wenigen Minuten
- flexible Datenschnittstellen zur Linienkommunikation sowie für MES und Traceability



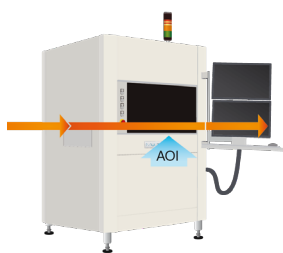
# Technische Spezifikationen

Kameramodule			
	2D-AOI-Modul	2D-AOI-Modul mit Schrägblick	3D-AOI-Modul
Bildaufnahme	orthogonales Kameramodul mit telezentrischer Optik	orthogonales Kameramodul mit telezentrischer Optik und 4 oder 8 Schrägblick-Kameramodule	3D/2D-Kameramodul mit orthogonaler Kamera, telezentrischer Optik und 3D-Bildaufnahme-Sensoren
Auflösung pro Bildpunkt	25 µm	25 µm (orthogonal) 35 µm (Schrägblick)	15 µm
max. Inspektionshöhe	bis zu 50 mm	bis zu 50 mm	35 mm
Bauteilfreiheit	bis zu 140 mm	bis zu 140 mm	40 mm (optional 50 mm oder 60 mm)
Einsatzmöglichkeit im Multi Line	Bauteilinspektion von oben	Bauteilinspektion von oben	Lötstellen- und Bauteilinspektion von oben und von unten
Multi Line Plattform			
max. Inspektionsbereich	540 mm x 450 mm		
max. Werkstückträgergröße	bis zu 620 mm x 510 mm		
Max. Transportgewicht	15 kg		
Energiebedarf	230 VAC/2 kVA, Druckluft 6 bar, Verbrauch < 20 l/h		
Transportsystem	Bandtransport für Baugruppen mit oder ohne Werkstückträger		
Transportrichtung	links-rechts, rechts-links, links-links, rechts-rechts		
Inline-Schnittstelle	SMEMA, HERMES, Siemens, Sensor		
Abmessungen (B x T x H)	1150 mm x 1300 mm x 1800 mm		
Gewicht	ca. 800 kg		

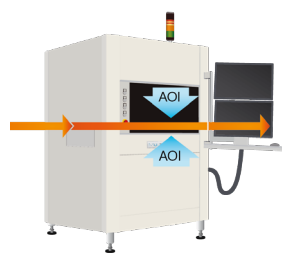
## Konfigurationsvarianten



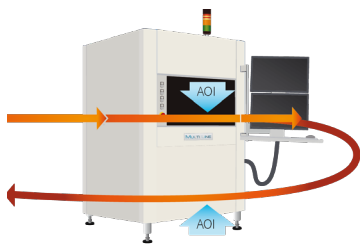
Inspektion von THT-Bauteilen



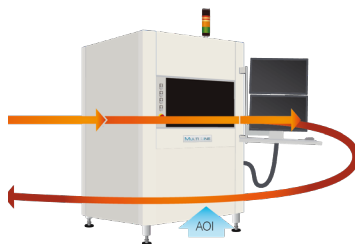
Inspektion von THT-Lötstellen



Inspektion von THT-Bauteilen und THT-Lötstellen im oberen Transportband



Inspektion von THT-Bauteilen im oberen und THT-Lötstellen im unteren Transportband



Inspektion von THT-Lötstelle im unteren Transportband

